

EPOXY 4089

特性

- ▶ 用于点胶应用
- ▶ 不垂流
- ▶ 恶劣环境使用特性
- ▶ 单组件环氧胶
- ▶ 高剪切强度
- ▶ 符合 RoHS

描述

Epoxy 4089 是单组件环氧胶，用于回流焊或波峰焊装配，粘合 SMT 元件和 PCB 双面板。Epoxy 4089 适用于所有类型的高速点胶设备，包括空压式、螺旋式、活塞式和夹管。Epoxy 4089 不垂流，不拖尾，并提供一致的点胶形状，尺寸以及容量。在非冷藏的条件下，Epoxy 4089 的保质期为 6 个月，其具有恶劣环境使用特性，可减少许多与其他芯片粘合环氧胶相关的使用问题。Epoxy 4089 具有足够的粘度，可用于高速贴片设备。

物理特性

参数	值
外观	浓液体
气味	芳香（轻微）
颜色	红色
粘度	300-500 kcps
沸点	> 260°C (500°F)

机械性能

参数	值
热变形温度	97°C (207°F)
抗拉强度	11,500 psi 典型值
延伸性 %	4.6 典型值
拉伸模量	4.9 psi x 10 ⁵ 典型值
Torque Strength	45 N.mm +/- 15 Typical



处理&储存

参数	时间	温度
非冷藏保质期	6 个月	< 25°C (77°F)

请勿储存靠近火源或明火。避免阳光直射，可能会降低产品质量。请勿将新的和使用过的黏胶储存在同一容器内。如果材料硬化或结晶，可将其加热 8 小时到 40°C (104°F) 至可用状态。

应用

Epoxy 4089 可直接使用，可提供 10cc 和 30cc 规格的 EFD 针筒包装，也可提供 Fuji 和 Iwashita 包装。环氧胶的点涂质量主要取决于点涂压力、时间、点胶喷嘴的大小和温度。粘胶强度因元件类型、胶粘点的大小、固化和阻焊膜类型不同。

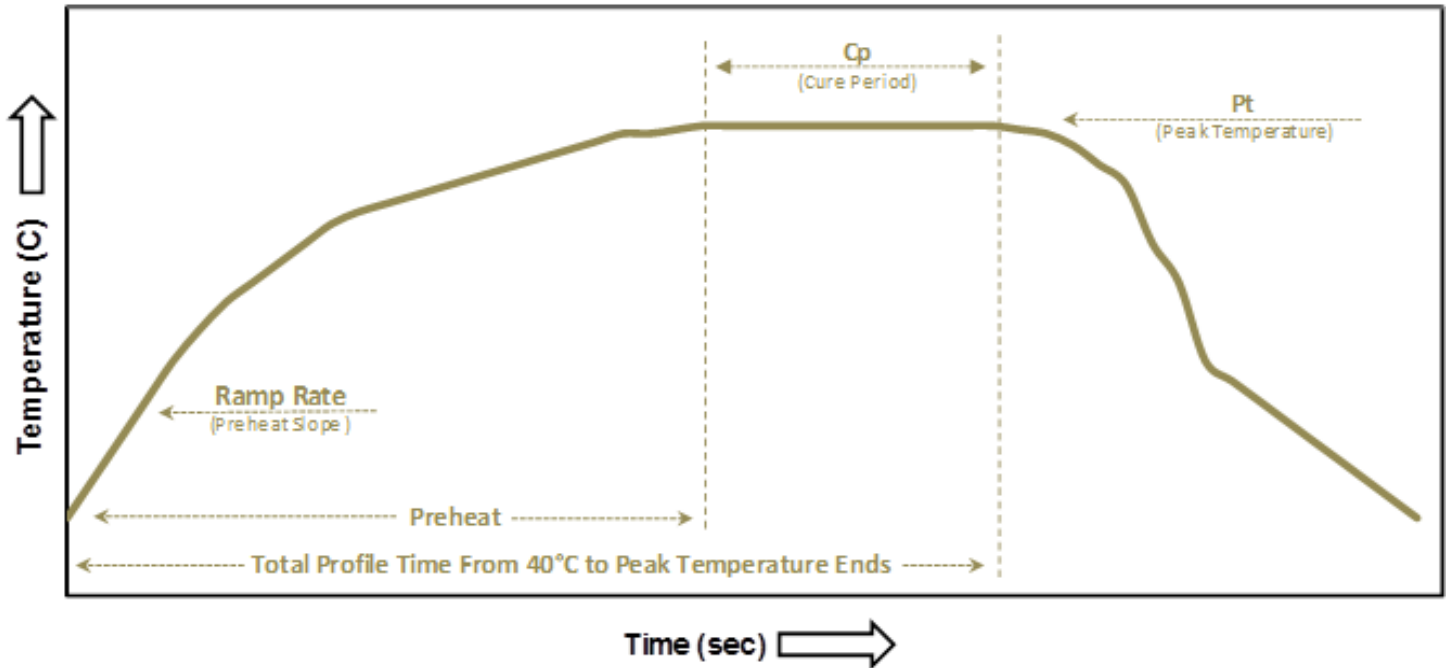
清洁

可用 IPA 去除基板上未固化的粘合胶，已固化或粘合了元件，加热至 120°C (250°F) 可软化 Epoxy 4089，以便去除。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。

推荐固化曲线



曲线特性	参数
升温斜率	1°C-2.5°C/秒
加热从 40°C 到 100°C	40-80 秒
加热从 100°C 到 120°C	50-70 秒
峰值温度 (Tp)	120°C-125°C
至峰值时间	60 秒
曲线合计时间	2.5-3.5 分钟

*曲线信息仅作参考。曲线可能因工艺和材料的可变因素而有所不同。